

# シリコンウェーハ用研磨スラリー



厳しい技術革新の続くシリコンウェーハの製造に用いられる、一次研磨・仕上げ研磨用のスラリーです。高平坦性、低欠陥、高生産性などの優れた研磨性能を安定して発揮いたします。

## Nanopure™シリーズ

Nanopure™ シリーズは、シリコンウェーハの一次研磨・二次研磨・仕上げ研磨・エッジ研磨用のスラリーです。

### ● 一次研磨用スラリー (NP6220、NP6500/NP6600シリーズ)

NP6220、NP6500/NP6600シリーズはシリコンウェーハの一次研磨用に開発されたスラリーです。NP6220はゾルゲル法コロイダルシリカゾルをベースとした高純度が特徴です。NP6500/NP6600シリーズは高希釈倍率においても高い加工効率を発揮する高機能スラリーです。目的、用途別に応じまして、各種品番をご用意しております。



## 物 性

Slurry	NP6220	NP6502	NP6504	NP6610	NP6605
Silica (wt%)	6.0	40.0	28.0	40.0	25.0
pH	11.0	11.0-12.5	11.0-13.0	11.0-12.0	11.0-12.5
Primary Particle Size (nm) *	35	50-70	50-70	50-70	10-20
Secondary Particle Size (nm) *	70	60-120	60-120	60-110	15-35
Alkali Additive (Polishing Accelerator)	Amine	Amine	Amine	Amineless	Amineless
Silica Purity	High Purity Colloidal Silica	Water Glass Colloidal Silica			Cu, Ni < 1-30 ppb
		e.g. Cu, Ni < 10-100 ppb			
Polished wafer metal level	◎	△	△	○	◎

\*Primary Particle Size: Calculation of surface area

\*Secondary Particle Size: Dynamic light scattering method

※ Nanopure™はニッタ・ハース社の商標です。

※ 記載されている物性値等の数値は代表値を示しており、製品の規格を保証するものではありません。また、本製品の仕様は、改良などにより予告なく変更することがあります。

## ● 仕上げ研磨用スラリー(NP8000シリーズ)

NP8000シリーズは、ディフェクトフリー、ヘイズフリーの完全鏡面を実現するために開発された仕上げ研磨用スラリーです。

高純度のコロイダルシリカゾルをベースとしており、デバイス性能に影響を及ぼす高い金属不純物要求にもお応えするスラリーをご用意いたしました。



### 物 性

Slurry	NP8020H	NP8020	NP8030	NP8040	NP8040W
Silica (wt%)	9.5	9.5	10.5	4.0	7.0
pH	10.0-11.0	10.0-11.0	10.0-11.0	10.0-11.0	10.0-11.0
Mean Particle Size (nm) *	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80
Silica Purity	High Purity Colloidal Silica				
	e.g. Cu, Ni < 0.5 ppb				
Remark	Semi Final Slurry (High removal rate)	Standard Final Slurry (200mm, 300mm)		Lower Cost Final Slurry (Reclaim, 200mm)	

\*Dynamic light scattering method

※ Nanopure™はニッタ・ハース社の商標です。

※ 記載されている物性値等の数値は代表値を示しており、製品の規格を保証するものではありません。また、本製品の仕様は、改良などにより予告なく変更することがあります。

## ● エッジ研磨用スラリー(EG1100シリーズ)

Nanopure™ EG1100シリーズはシリコンウェーハのエッジ研磨用に開発されたスラリーです。EG1103は高希釈倍率においても高い加工効率を発揮するスラリーで、お客様でのコスト低減に寄与します。

### 物 性

Slurry	EG1103
Silica (wt%)	35.0
pH	11.2
Viscosity (25°C)	2.5
Mean Particle Size (nm) *	100
Specific Gravity (25/25°C)	1.26
Silica Purity	Water Glass Colloidal Silica
Polished wafer metal level	○

\*Dynamic light scattering method

※ Nanopure™はニッタ・ハース社の商標です。

※ 記載されている物性値等の数値は代表値を示しており、製品の規格を保証するものではありません。また、本製品の仕様は、改良などにより予告なく変更することがあります。